



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 16

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 施加的压力       | 标准       |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装母端 |
| 连接器系统       | 板对板      |
| Sealable    | 否        |
| 连接器和端子端接到   | 印刷电路板    |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 行数                  | 2  |
| 可堆叠                 | 是  |
| PCB 安装方向            | 垂直 |
| Number of Positions | 16 |
| 板对板配置               | 平行 |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 介质耐压（最大值）         | 750 VAC |
| 绝缘电阻              | 5000 MΩ |
| Operating Voltage | 333 VAC |

主体特性

|       |   |
|-------|---|
| 连接器外形 | 低 |
|-------|---|

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 端子接触部长度          | 2.54 mm[.1 in]  |
| 接合方柱尺寸           | .64 mm[.025 in] |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 3.81 – 7.62 µm  |
| 端子形状和构造          | 短点              |
| PCB 端子端接区域电镀材料   | 锡               |
| 端子基材             | 磷青铜             |
| 端子接触部电镀材料        | 金               |
| 端子接合区域电镀材料厚度     | .762 µm[30 µin] |
| 端子类型             | 插座              |
| 端子额定电流（最大值）      | 3 A             |

端接特性

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 矩形端接柱体和尾部厚度 | .2 mm[.008 in]   |
| 矩形端接柱体和尾部宽度 | .7 mm[.028 in]   |
| 端接柱体和尾部长度   | 3.18 mm[.125 in] |
| PCB 端接方法    | 通孔 - 焊接          |

机械附件

|          |     |
|----------|-----|
| 接合对准     | 不带  |
| PCB 安装固定 | 不带  |
| PCB 安装对准 | 不带  |
| 连接器安装类型  | 板安装 |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 接合入口位置  | 底部和顶部          |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |
| 壳体颜色    | 黑色             |
| 外壳材料    | 聚酯 - GF        |

尺寸

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 连接器高度              | 6.2 mm[.245 in]         |
| Row-to-Row Spacing | 2.54 mm[.1 in]          |
| 堆叠高度               | 2.29 mm[.09 in]         |
| PCB 厚度（建议）         | 1.57 mm[.055 – .094 in] |

使用环境

|         |    |
|---------|----|
| 壳体温度额定值 | 标准 |
|---------|----|

工作温度范围

-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

操作/应用

|        |        |
|--------|--------|
| 焊接工艺特性 | 板支座    |
| 电路应用   | Signal |

行业标准

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 已批准的标准   | CSA LR7189, UL E28476 |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0              |

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装数量 | 28        |
| 封装方法 | Tube, 盒和管 |

其他

|    |                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 注释 | TE 建议使用接合金或带双层电镀母端配件的双层电镀公端。 , 为了获得最小接合柱长度，在最大触点尺寸上增加 .51 [.020]（不包含斜面上的柱引线）。 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                                           |

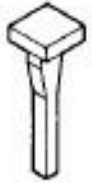
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 86286-1  
KEYING PLUG

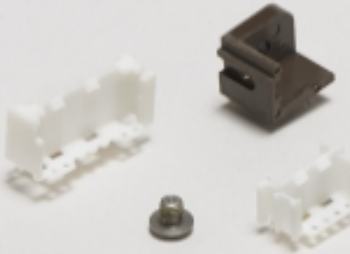


TE 产品编号 5-104436-8  
16 MODII HDR DRRA B/A W/HLDWN

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V



PCB 插销、锁和固定器(9)



PCB 连接器安装(1)



PCB 连接器应力消除(3)



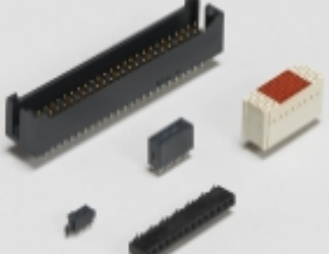
PCB 连接器盖(18)



PCB 连接器键控(6)



插入和拔出工具(4)



板对板接头和插座(937)



板对板连接器端子(6)



标准矩形连接器(8)



汽车接头(2)



汽车连接器护套(4)



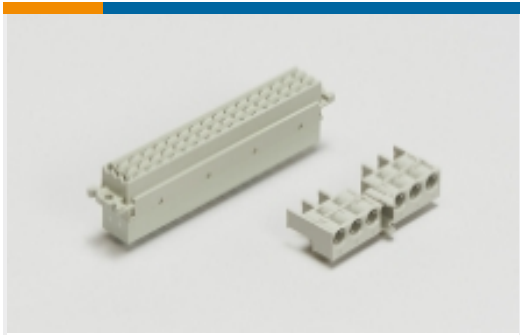
矩形连接器壳体(5)



线到板连接器组件和护套(472)

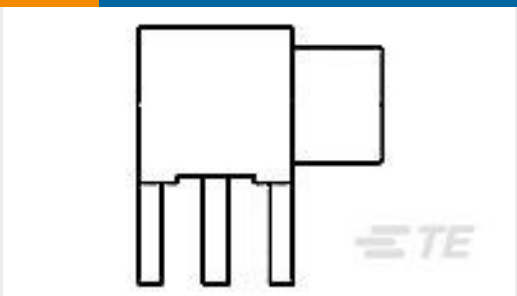


线对板连接器端子(328)

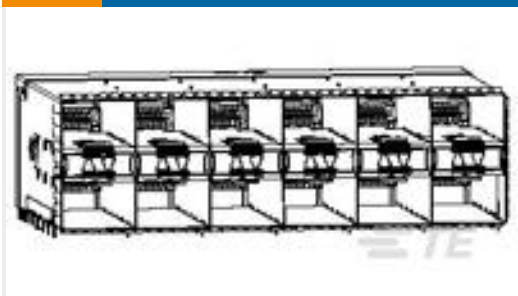


背板连接器壳体(1)

客户还购买了



TE 产品编号1363128-1  
9664 0000 09



TE 产品编号2198339-7  
zSFP+ STACKED 2X6 RECEPTACLE ASSEMBLY



TE 产品编号1551920-5  
ZQSFP+ CONNECTOR ASSEMBLY



TE 产品编号2170790-7  
CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, SPRING, HS



TE 产品编号2178531-4  
CC - Crown Clip Junior AG Plating Reflow



TE 产品编号2298896-4  
2X1 QSFP+ SPRING CAGE AND CONN W/O LP



TE 产品编号4-5353190-1  
.6FHR04H,100,S,GIG,30/Sn,TR,NSYes



TE 产品编号6646495-1  
CONNECTOR,SOCKET,FLATPAQ

文档

产品图纸

16 MODIV VRT DR DE 100/125

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_6-534267-9\_AB.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_6-534267-9\_AB.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_6-534267-9\_AB.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

应用规格

英文版本